

Cho-Bond 584-208

产品名称	Cho-Bond 584-208
公司名称	上海恩莱保贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区金高路2388号813室
联系电话	86-021-20228098 13391171050

产品详情

粘合剂为电路板维修提供了极其简便的应用。

它是一种双组分体系，混合比为1：1，在室温下24小时固化。

在0.75小时的高温固化温度212 ° F (100 ° C) 下，该材料的体积电阻率为0.005欧姆 - 厘米。

Adhesive offers exceptional ease of application for circuit board repair. It is a two- component system with a 1:1 mix ratio, and cures in 24 hours at room temperature. With a 0.75 hour elevated cure temperature of 212 ° F (100 ° C), the material offers volume resistivity of 0.005 ohm-cm.